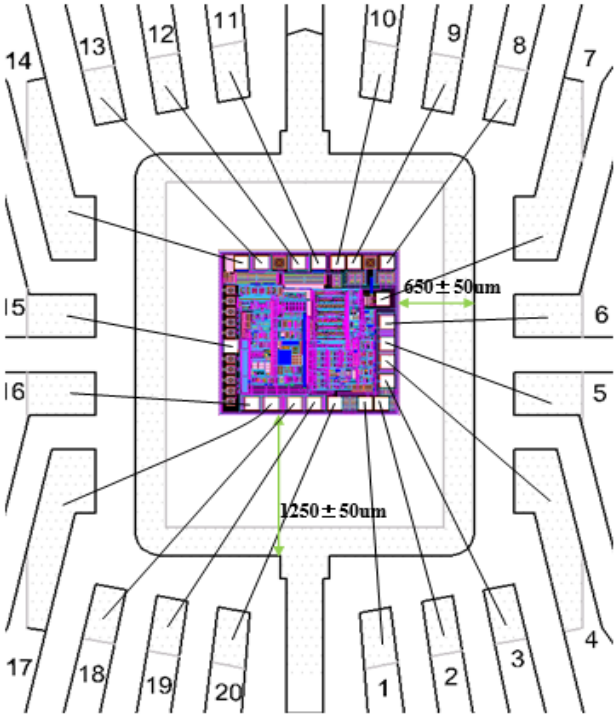


文件编号:		20220316MT-341-DIP20-HS8108B-01							
客户		341		封装形式		DIP20L			
一、芯片资料				二、粘片及打线图					
产品型号		HS8108B							
芯片数		芯片a						芯片b	
芯片型号		HS5016							
芯片尺寸(um ²)		1095*1128							
芯片类型									
铝垫尺寸BP0(um ²)		70*70							
焊点最小BPP (um)		90							
铝垫成份		<input type="checkbox"/> 纯铝						<input type="checkbox"/> 纯铝	
		<input checked="" type="checkbox"/> 铝铜						<input type="checkbox"/> 铝铜	
		<input type="checkbox"/> 铝硅						<input type="checkbox"/> 铝硅	
		<input type="checkbox"/> 铝硅铜		<input type="checkbox"/> 铝硅铜					
铝层数		<input type="checkbox"/> 单层布线		<input type="checkbox"/> 单层布线					
		<input type="checkbox"/> 双层布线		<input type="checkbox"/> 双层布线					
		<input type="checkbox"/> 其它		<input type="checkbox"/> 其它					
铝垫厚度(um)		顶层铝1厚0.8		顶层铝厚					
是否为MOS或BJT		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
是否有有害物质超标,若有请说明		<input type="checkbox"/> 铅 <input type="checkbox"/> 汞		<input type="checkbox"/> 铅 <input type="checkbox"/> 汞					
		<input type="checkbox"/> 铬 <input type="checkbox"/> 镉		<input type="checkbox"/> 铬 <input type="checkbox"/> 镉					
三、封装资料									
芯片数		芯片a		芯片b					
是否要减薄		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
减薄厚度要求		减薄至280±10um							
焊垫是否为CUP		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
备注									
四、封装其它要求				六、打印要求		说明栏			
加工类型		<input checked="" type="checkbox"/> 封装 <input type="checkbox"/> 封装+OS <input type="checkbox"/> 封装+FT <input type="checkbox"/> 封测编							
散热要求		<input type="checkbox"/> <5W/m.K <input type="checkbox"/> 5-20W/m.K <input type="checkbox"/> >20W/m.K							
工作电压		<input type="checkbox"/> <500V <input type="checkbox"/> 500-600V <input type="checkbox"/> 600-700V <input type="checkbox"/> 700-800V <input type="checkbox"/> >800V							
工作电流(A)									
工作结温Tj		<input type="checkbox"/> 80℃ <input type="checkbox"/> 100℃ <input type="checkbox"/> 120℃ <input type="checkbox"/> 150℃							
回流焊或波峰焊		<input type="checkbox"/> 240度 <input type="checkbox"/> 260度 <input type="checkbox"/> 其它							
五、物料清单BOM									
材料		型号							
框架		DIP20L (2P) 铜框架 (110×140mil2)							
焊线		Φ25um铜线(20wire)							
粘片胶	芯片a	<input checked="" type="checkbox"/> 导电胶 <input type="checkbox"/> 绝缘胶 首选:		S210		备选:			
	芯片b	<input type="checkbox"/> 导电胶 <input type="checkbox"/> 绝缘胶 首选:				备选:			
塑封料		<input type="checkbox"/> 无铅 <input checked="" type="checkbox"/> 无卤 首选:		EMG-350		备选:			
拟制		杨俊		研发部审批		品质部审批			
日期		20220316		日期		日期			
七、备注说明									
1、客户在回签此确认书时,要求填写芯片资料、封装资料及封装其他要求中的有关内容,以便于设置封装工艺。若未填写,我司就以我司工程验证的信息内容为主进行生产;									
2、根据贵司要求,参照贵司提供订单、芯片打线图及印章要求制定本工艺确认书。客户确认打线、印章图是否符合客户要求,请确认;									
3、客户在确认此文件时,对产品使用要求,如散热、工作电压、工作电流、工作结温及可靠性要求进行填写,以便于我司根据贵司使用要求进行物料选取。若未进行填写,我们就以本确认书推荐物料进行生产。									
4、对双方质量协议、终端使用环境要求了解的情况下,客户确认回签此文件。若终端使用环境要求有改变,须提前告知我司;									
5、产品完成工程试封后,客户端务必进行终端使用环境及电性能测试(如带电老化),考核通过后才能进行量产。									
八、客户回签及特殊要求									
客户要求及回签									